## CBRAM 抵抗変化に伴う電気化学パラメ-タ変化のインピーダンス解析

The Electrochemical impedance analysis of electrochemical parameter changes

with CBRAM resistive switching

東理大理<sup>10</sup>(M2)川並将太朗<sup>1</sup>,五十嵐聡人<sup>1</sup>,木下健太郎<sup>1</sup>

## Tokyo Univ. of Sci.<sup>1</sup>, °Shotaro Kawanami<sup>1</sup>, Akito Igarashi, and Kentaro Kinoshita<sup>1</sup>

## E-mail: 1518512@ed.tus.ac.jp

【序論】導電性ブリッジメモリ(CBRAM)は, 遷移金属酸化物(TMO)を銅などの活性電極(AE)と Pt などの不 活性電極(IE)で挟み込んだ簡易な構造を持ち, 次世代の不揮発性メモリとして期待されている. CBRAM の抵 抗スイッチング(RS)は, 異なる時定数を持つ①AE/TMO (TMO/IE)間の金属原子の溶出(析出), ②溶出した 金属イオンの TMO 薄膜中での拡散という電気化学反応を伴う2つのプロセスから構成されている[1]. 我々は電気化学インピーダンス法(EIS法)を用いて, 各電気化学パラメータの面積依存を詳細に調べる事で,

パラメータの素子内分布を明らかに出来ることを示した[2]. 先 の報告は初期状態(IRS)におけるものであったため、本研究では RS 前後における電気化学パラメータの素子内分布の変化を調査 した.【実験方法】I-V 測定と EIS 測定を Cu/Ta2O5/Pt 構造(電極直 径: 200, 150, 100, 80 µm)の CBRAM に適用し, 高抵抗状態(HRS) と低抵抗状態(LRS)の電荷移動抵抗 Ret と電気二重層(EDL)容量 Cdl の測定を行った.【結果と検討】Fig.1及びその挿入図に IRS と LRS の素子に EIS 測定を行うことで得られた Zre v.s.-Zim plot (Nyquist plot)をそれぞれ示す. IRS 及び HRS(図中示さず)では, R<sub>ct</sub> と C<sub>dl</sub> に 起因する容量性半円が観測された.一方、LRSでは誘導性挙動が 支配的であった. Nyquist plot から Fig.1 の等価回路を用いて, R<sub>et</sub>と Cdl を見積もった. Fig. 2 に RS 現象の試行数に対する Rct と Cdl の 変化を示す. 同図より HRS では直流抵抗  $R_{dc} = R_{ct}$ なので,  $R_{dc}$ は AE からの金属原子の溶出しやすさで決まると言える. また, Cdlも Rdcの増減に追随して変化する. Fig.3 に示すように IRS の 抵抗値は面積に逆比例し, AE からの金属溶出は素子全面におい て起きることが分かる.RSを経験した後は面積依存性が見られな い事と Fig.2 の結果から、金属架橋の成長と共に gap 間に電場が

集中して、金属原子の溶出が局所的 になり、 $R_{dc}$ は gap 幅で決定される事 が示唆される.対照的に  $C_{dl}$ は RS 現象を繰り返しても、IRS、HRS 共 に面積依存性を保つ.この結果は 一見、 $R_{dc}$ (金属架橋形成)に追随して  $C_{dl}$ が変化するという Fig.2 の結果と 矛盾するようにも見えるが、Fig.3

の挿入図に示すように, 金属架橋は



[0] miZ-3

10<sup>4</sup>

 $10^{3}$ 

10<sup>2</sup>

10<sup>-1</sup>

 $10^{-3}$ 

0

 $\frac{\overline{\mathrm{G}}}{\underline{\mathrm{G}}} \frac{10^1}{10^0}$ 

RS RS RS RS

10

20

30

cycle number

40

HRS

10<sup>-2</sup>

60 80 Zre [MΩ]

3

6 : 80 um

9

16

14

12

10

8 E

4

2

0

50

6

Resistive

witching :R

Rc

Zre [MΩ]

Fig. 1 Nyquist plot plot of IRS and LRS

Inset: LRS(1) and Equivalent circuit (2).

Fig. 3 S dependence of  $R_{ct}$  and  $C_{dl}$ . Inset : Internal structure of CBRAM.

EDL を横切って成長し, 架橋部が太くなれば( $R_{dc}$ が小さくなれば) 空乏層面積が減る( $C_{dl}$ が小さくなる)ため であると考えれば辻褄が合う. この様に EIS 法による  $R_{ct}$ ,  $C_{dl}$ の面積依存性評価を通じて RS に伴う, 金属 架橋の縦(gap 間隔), 横(太さ) 両方向への成長や減退の様子を把握する事が可能である.

[1] K. Kinoshita, ECS Transactions 69 (2015) 11. [2] A, Hukushima, et al, The 48<sup>th</sup> SSDM (2016)